

瑞芯微电子股份有限公司
关于参加沪市主板新质领航之电子与通信行业
2025 年度集体业绩说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日参加了沪市主板新质领航之电子与通信行业 2025 年度集体业绩说明会，就公司 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果和财务状况与投资者进行了沟通与交流。现将有关内容公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00-17:00，公司参加了由上海证券交易所举办的沪市主板新质领航之电子与通信行业 2025 年度集体业绩说明会，公司董事、副总经理兼 CFO 王海闽先生、副总经理李诗勤先生、独立董事乔政先生、董事会秘书林玉秋女士出席会议，与投资者进行现场及线上的互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题 1：去年国务院正式发布了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出“推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合”；同时“十五五规划建议”进一步提出，“全面实施‘人工智能+’行动，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。”公司作为 AI 端侧龙头企业，在此背景下如何把握未来发展机遇？

回复：依托云端大模型快速迭代，AI 技术逐步向终端渗透，在多样的应用场景中与终端产品深度结合，端侧 AI 成为继云端 AI 后的下一波确定性浪潮，千行百业电子产品正在被 AI 技术重塑。各类机器人、AI 座舱、AI 视觉检测、AI 影像设备、AI 眼镜、AI 玩具等创新硬件不断涌现，教育、家庭、医疗以及工业、

农业、服务业等各领域传统电子产品都值得用 AI 重做一遍，市场应用前景广阔，将驱动未来 5~10 年边缘侧、端侧的 AIoT 高速发展。

同时我们可以看到，这一轮 AI 端侧产业发展主要在中国。一方面，国内拥有完备的产业链、海量的行业场景资源、深厚的技术积累以及庞大的市场规模，发展端侧 AI 有着天然优势；另一方面，从您刚提到的《实施意见》可以看出，国家高度重视 AI 应用的落地，旨在用 AI 改造传统产业，驱动新质生产力发展，从政策层面为 AI 技术深度赋能千行百业创造了良好的发展环境。

作为国内 AIoT 的领先者，瑞芯微积累了深厚的行业认知与广泛的全球客户群体，产品应用遍布千行百业，处在这一发展机遇的极佳位置。公司将持续以 SoC+协处理器引领端侧 AI 发展，联合产业链生态伙伴深入应用场景，共同解决其与人工智能结合的痛点，让 AI 在各种场景中发挥价值。例如在工业领域，搭载公司 RK3588+RK1828 的新型工业质检应用解决方案，可以通过灵活部署多种视觉模型，高效满足工业产线实时缺陷检测需求；例如在智能家居领域，基于 RK3588+RK1820 的智能影像应用解决方案，能够实现端侧实时 AI 影像处理并满足智能交互需求。因应端侧 AI 快速发展机遇，公司将通过开放易用的工具链、深度合作的算法生态以及可快速复用的行业参考设计，构建“芯片+算法+行业方案”的综合能力持续赋能千行百业。

问题 2：请问管理层，如何看待当前 AI 需求外溢为公司带来的结构性增长机遇？面对未来 5 到 10 年 AI 与实体经济深度融合的机遇，公司在新兴高潜力赛道的研发投入与资源分配上，有着怎样的顶层设计与战略考量？

回复：随着模型能力密度的持续提升，大模型的小型化、专业化发展进程进一步提速，形成端侧落地的技术基础；同时，大模型本地部署是刚需，有云端不可替代的众多优势，比如低延时、低网络依赖、数据安全、隐私保护以及成本可控等，非常适合农业、工业、汽车、各种机器人、家庭等各行各业场景智能化升级的核心需求。因此，大模型在端侧产品的落地正高速发展，将在未来几年大爆发。

因应端侧 AI 的快速发展，公司在 2025 年确立 SoC 与协处理器双轨并行的产品线，高度重视“双轨制”研发思路，并作为公司的战略重点。以现有的 RK3588、RK3576、RK3572 等系列 SoC 满足通用计算需求，承担控制、执行和部分计算的功能；以新推出的 RK182X 系列协处理器聚焦端侧大模型运行，承担主动感

知、推理决策等复杂 AI 功能。通过将不同性能的 SoC 与不同算力水平的协处理器灵活搭配，为 AIoT 新硬件提供“感知、决策、控制、执行”的全链路闭环能力，精准兼顾各种端侧复杂应用需求。

未来，公司将持续加大研发投入，加快产品矩阵的不断完善，缩短平台的迭代周期。一方面，根据未来 AIoT 新硬件发展的核心技术点，持续迭代 NPU、ISP、音视频编解码等核心自研 IP，为芯片产品的性能升级提供底层的技术基础；另一方面，在研发更高性能的 RK3668、RK3688 系列 SoC 芯片的同时，加快推出 RK1860、RK1899 等一系列涵盖更高算力以及更低功耗的协处理器平台，充分满足 AIoT 新硬件对不同端侧大模型的差异化需求，当然，我们会高度重视 AI For IC，将人工智能技术赋能我们的芯片设计流程，更快更好地推出新平台，全面拥抱端侧 AI 的重大发展机遇。

问题 3：在 AI 赋能新质生产力发展的背景下，各类新兴应用层出不穷，端侧 AI 芯片价值持续显现，软硬件生态已成为行业竞争关键。请问公司在生态建设方面都有哪些布局？未来将如何依托生态建设，持续挖掘新兴应用需求、巩固行业地位优势？

回复：随着 AIoT 进入“模型创新驱动”的 2.0 时代，我们深刻地认识到，仅凭单一的技术优势无法做好 AIoT 新硬件，芯片、模型、算法、数据与场景的深度协同联动已经成为产业发展的关键。因此，瑞芯微不仅提供丰富的芯片解决方案，更致力于推动构建完善的产业生态，成为兼具平台、产品、生态一体的公司。

过去的一年里，公司先后举办瑞芯微第九届开发者大会、瑞芯微首届 AI 软件生态大会，汇聚了 AI 算法模型、软件及产业应用的众多合作伙伴及终端客户，务实开展技术对接。一方面，公司准备好了丰富的芯片平台、平台化的底层软件、易用的软件开发接口等，广泛支持各软件生态伙伴的算法和模型，实现硬件算力与算法模型的深度协同；另一方面，依托在 AIoT 千行百业的广大生态，为 AI 软件伙伴与终端客户搭建产品需求对接桥梁，实现优势互补、共赢合作，构建起从基座模型到终端场景的完整 AI 落地能力。

未来，公司将持续加强产业链生态建设，举办开发者大会和 AI 软件生态大会，构筑一个稳定、开放的长期交流与合作平台；同时坚持软硬件协同发展，以公司芯片平台为算力基座，不断扩展算法模型的支持范围，协同客户和生态伙伴

下沉一线，聚焦行业痛点与潜在需求，深挖汽车电子、机器人、机器视觉、智慧工业、智能家居等创新应用场景，携手做出世界一流的 AIoT 创新产品，加速推动 AI 向千行百业渗透融合。

问题 4：公司在去年推出协处理器 RK182X，并称该产品是部署端侧 AI 最合适的解决方案，把协处理器放到和 SoC 并列的产品战略高度。请问目前市场对该技术路线的接受度如何，为公司在端侧 AI 快速发展的时代下取得哪些领先优势？

回复：端侧大模型落地面临的核心挑战在于大模型推理对芯片算力、运力和存力的动态平衡要求，以及端侧 AIoT 应用对设备功耗、成本价格、产品空间等都提出了更高的要求，实际上二者存在明显的矛盾，怎么解决？瑞芯微协处理器系列产品很好满足端侧产品的要求同时在带宽和功耗上有明显的优势。此外，针对 AIoT 快速发展、产品频繁升级换代趋势，以及千行百业产品差异化明显、算力需求多样的特点，协处理器的方案为客户提供了充分的灵活性和可扩展性，让客户可以根据自身对产品和场景的实际需求，选择不同的协处理器，并能快速实现算力、性能的升级，甚至在主平台不改变的情况下，最小程度修改硬件，通过局部升级软件，极大减少人力投入、缩短产品上市周期。因此，基本上我们和客户形成了共识，协处理器方案不仅解决了技术上的问题，还非常符合端侧 AI 的诉求，几乎是当前端侧 AI 的最优架构。

当前端侧大模型加速落地千行百业，公司第一代协处理器 RK1820、RK1828 构建起公司核心技术和产品领先优势，更为公司筑牢生态壁垒抢占先机。RK182X 自推出后获得业内广泛认可，目前已有数百个客户、几十个行业在研发中，应用场景覆盖各类机器人、车载 AI BOX、机器视觉、智慧工业、智能家居等众多领域，首批客户已进入产品发布、量产阶段。

基于 RK182X 的成功经验，公司正快速推进下一代协处理器系列产品研发工作，继续扩大产品领先布局，持续系统优化、完善工具链；同时，公司重点加强行业生态的深度合作，联合众多生态伙伴，全面适配各类操作系统、AI 软件、算法，以及包括视觉大模型、大语言模型、多模态等在内的各类主流 AI 端侧大模型，大幅降低终端客户的开发门槛，帮助客户快速实现产品的研发与规模化量产，不断巩固并扩大在端侧 AI 的领先优势。

问题 5：我们关注到公司的业绩从 2024 年、2025 年再到 2026 年 Q1 持续保

持高速增长，刚刚管理层也向我们介绍了过去 25 年和 26 年 Q1 增长的原因，我想再进一步问下管理层，如何看待后续公司业绩持续高增的动能？

回复：端侧 AI 深入千行百业、重塑产品的趋势不断加强，边缘侧、端侧 AIoT 正处于快速发展的成长周期。从今年来看，在存储价格高企、上游成本上涨等严峻的市场环境下，即使消费电子承压，公司长期深耕布局的 AIoT 和新质生产力产品仍保持着顽强的生命力，公司一季度收入同比增长 36%，净利润同比增长 57%，均创下同期历史新高。

在端侧 AI 快速发展背景下，汽车电子、机器人、机器视觉、工业、农业、服务业等 AIoT 各行各业具备广阔市场前景。未来几年，随着公司 SoC 与协处理器双轨制产品发展战略逐步落地，以 RK35 系列、RK36 系列为代表的公司 SoC 业务将保持快速增长；同时 RK18 系列协处理器开辟公司第二增长曲线，帮助瑞芯微在不断提升现有市场渗透率的同时进一步拓宽新的应用领域，持续释放业绩增量，驱动公司未来数年高质量发展。

问题 6：当前行业朝着自主化、高端化方向稳步前行，请问公司结合自身经营情况，后续在产业协同与稳健发展方面有哪些规划思路？

回复：一方面，公司立足于 AIoT 技术、产品积累，SoC、协处理器双轨产品不断向更高性能、更先进制程迭代，持续打造“感知、决策、控制、执行”的全链路产品升级；同时积极布局具有合适性价比的产品，为客户提供一系列解决方案，引领端侧 AIoT 高速发展。

另一方面，公司依托 AIoT 数千家客户生态布局，重点推进 AI 软件合作，全面适配各类操作系统、软件、AI 算法，以及包括视觉大模型、大语言模型、多模态及音频等在内的各类主流 AI 端侧大模型；协同客户和生态伙伴深入场景一线，聚焦解决产品痛点，加速推动 AI 向千行百业渗透融合。

问题 7：预计 RK182x 从哪个季度可以开始贡献营收？

回复：当前端侧大模型加速落地千行百业，公司第一代协处理器 RK182X 构建起公司核心技术和产品领先优势，更为公司筑牢生态壁垒抢占先机。RK182X 自推出后获得业内广泛认可，目前已有数百个客户、几十个行业在研发中，应用场景覆盖各类机器人、车载 AI BOX、机器视觉、智慧工业、智能家居等众多领域，首批客户已进入产品发布、量产阶段；将在下半年放量。

问题 8：公司对于人形机器人领域的产品布局和新产品的研发布局是怎样

的？未来产品对于该领域的特点有什么适配，公司产品有什么技术优势？

回复：公司深耕机器人赛道，已形成从底层控制到上层智能的全栈式芯片应用解决方案，截至目前，公司 RK3588、RK3576、RK3568/66、RK3562、RV1126B 等芯片平台以及新推出的协处理器系列产品不仅可应用在人形机器人领域，也广泛用在工业智能（制造/巡检/搬运/操作等）、农业智能（采摘/播种/喷洒/巡检等）、智能服务（配送/清扫/家政/教育等）、智能陪伴（仿生/玩偶/玩具类等）等多品类机器人。

机器人是集感知、决策、执行一体化的 AIoT 标志性创新产品，公司基于在 AIoT 领域多年持续的“大音频、大视频、大感知、大软件”核心技术积累，产品矩阵能够覆盖机器人的运动控制、视觉感知、推理决策、业务交互、音频交互等众多场景，未来公司将继续迭代核心 SoC 处理器及协处理器系列，为多品类机器人提供更高性能的芯片底座，助力机器人加速赋能各行各业。

问题 9：当前公司对于人形机器人领域的营收占比如何？如何看待这一行业的空间？未来产能规划和投入的战略和战术布局如何？

回复：人形机器人场景需求明确，未来市场前景广阔，目前人形机器人的市场和技术还在发展中。公司芯片产品已在人形机器人广泛应用，将持续以“SoC+协处理器”为客户提供从感知到交互的全栈式能力。

问题 10：近期公司刚推出了 RK3572，请问该产品的主要应用场景和产品出货情况？是否会替代 3588/3576 应用？

回复：RK3572 采用 8nm 先进制程，搭载八核 CPU，内置 4TOPS NPU，性能强劲；支持 2B 参数级的大模型部署，及各类 AI 算法的应用；可支持 LPDDR5/5x，为客户提供灵活的存储方案选择。RK3572 产品设计紧密围绕中端 AIoT 的场景需求，可广泛应用于平板电脑与移动终端、AI 摄像头、智能 NVR、NAS、台式收银 POS 机、交互式数字标牌、自助设备等。

RK3572 与 RK3588、RK3576 形成 8nm 先进制程下“旗舰-高端-中端”完整产品矩阵，充分满足同一客户不同档位产品的需求，并依托公司良好的跨平台移植性，帮助客户降低投入成本、快速实现量产。目前该产品已在下游各目标市场大力推广，已有多家终端客户方案正在开发中，将在 2026 年贡献业绩增量。

问题 11：大家都对瑞芯微“用一颗芯片打遍数百个行业”很不可思议，公司是怎么看的？

回复：“芯进百业”的前提是公司芯片平台的“通用性”和“易用性”：通用的芯片平台契合 AIoT 场景化、碎片化的特点，辅之以平台化的底层软件及齐全的操作系统、软件、算法及 AI 端侧大模型适配，满足 AIoT 千行百业的客户产品开发需求，助力客户项目快速量产。其核心离不开公司在 AIoT 领域的长期深耕，并与众多业内伙伴的聚合发展。长期深耕为公司建立起平台化的 AIoT 芯片矩阵、广泛的客户群体以及千行百业的下游市场；同时，随着合作伙伴的持续扩容与应用场景的不断富集，“用得越多、迭代越快、适配越广”的平台网络效应进一步强化，公司对未来技术需求判断及芯片前瞻性定义的能力逐步增强，芯片平台技术复用率与 AIoT 场景覆盖广度持续提高，成为公司在 AIoT 领域独有的系统性竞争优势。

问题 12：请说明第二大股东为何在此时间节点减持股份？有什么原因？会否影响其它股东持股信心？

回复：股东黄旭已于 2025 年初退休，不再参与公司日常运营；作为外部股东，减持系其自身阶段性资金需求的个人行为。

当前 AI 技术日新月异，云端 AI 的投资在高速增长。而 AI 在产品上的落地，必须要有可以在终端产品本地部署的端侧 AI 模型。端侧 AI 是未来，是 AI 落地的战略必经之路。

公司作为国内 AIoT 芯片的领先者，提供一系列 SoC+协处理器芯片，与百行百业的客户共同打造端侧 AI 赋能的高价值终端产品。公司有信心在今年以及可见的未来数年内保持良好增长态势。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的召开情况及具体内容，投资者可登陆上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，有关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日